



## 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2023年2月9日

上場会社名 東京エレクトロン株式会社

上場取引所 東

コード番号 8035 URL <https://www.tel.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 河合 利樹

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 松村 晃文

TEL 03-5561-7000

四半期報告書提出予定日 2023年2月13日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

### 1. 2023年3月期第3四半期の連結業績(2022年4月1日～2022年12月31日)

#### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2023年3月期第3四半期	1,650,729	14.7	464,936	8.0	470,229	8.5	352,920	13.8
2022年3月期第3四半期	1,438,988	49.9	430,691	104.8	433,380	105.7	310,246	96.1

(注)包括利益 2023年3月期第3四半期 336,308百万円 (△5.6%) 2022年3月期第3四半期 356,316百万円 (89.5%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2023年3月期第3四半期	2,263.31	2,254.03
2022年3月期第3四半期	1,993.38	1,983.22

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2023年3月期第3四半期	2,092,760	1,434,398	68.0
2022年3月期	1,894,457	1,347,048	70.5

(参考)自己資本 2023年3月期第3四半期 1,422,134百万円 2022年3月期 1,335,152百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2022年3月期	—	643.00	—	760.00	1,403.00
2023年3月期	—	857.00	—	—	—
2023年3月期(予想)	—	—	—	731.00	1,588.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

2023年3月期の期末配当金731円には、創立60周年記念配当200円を含んでおります。

### 3. 2023年3月期の連結業績予想(2022年4月1日～2023年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	2,170,000	8.3	580,000	△3.2	584,000	△2.9	433,000	△0.9	2,776.15

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

詳細は、【添付資料】10ページ「2.四半期連結財務諸表及び主な注記(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	2023年3月期3Q	157,210,911 株	2022年3月期	157,210,911 株
② 期末自己株式数	2023年3月期3Q	1,120,645 株	2022年3月期	1,461,581 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2023年3月期3Q	155,931,429 株	2022年3月期3Q	155,638,190 株

(注) 期末自己株式数には、「役員報酬BIP信託」及び「株式付与ESOP信託」が保有する当社株式(2023年3月期3Q 501,673株、2022年3月期 610,529株)を含めております。また、各信託が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】5ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報(4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

・当社は、2023年2月9日に機関投資家・アナリスト向けにウェブ説明会を開催する予定です。この説明会で使用する決算説明資料につきましては、当社ホームページに掲載する予定です。

**【添付資料】**

## [目次]

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) キャッシュ・フローに関する説明	4
(4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	5
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	6
(1) 四半期連結貸借対照表	6
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	8
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)	10
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	10
(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)	10
(セグメント情報等)	11
(重要な後発事象)	12

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間の世界経済につきましては、地政学リスクの高まりに伴う資源・エネルギー価格の高騰及び諸物価の上昇、欧米諸国を中心とした政策金利の引き上げや急激な為替変動、新型コロナウイルス感染症に伴う一部地域でのサプライチェーンへの影響等、注視すべき状況が継続しました。

一方、当社グループの参画しておりますエレクトロニクス産業におきましては、情報通信技術の拡充に伴うデータ社会への移行や脱炭素社会への取り組みを背景に、半導体の重要性が高まっており、半導体製造装置市場は中長期的な成長が見込まれております。

このような状況のもと、当社グループの当第3四半期連結累計期間の連結業績は、売上高1兆6,507億2千9百万円(前年同期比14.7%増)、営業利益4,649億3千6百万円(前年同期比8.0%増)、経常利益4,702億2千9百万円(前年同期比8.5%増)、また、親会社株主に帰属する四半期純利益は3,529億2千万円(前年同期比13.8%増)となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりです。

#### ① 半導体製造装置

ロジック/ファウンドリ向け半導体に対する設備投資は、社会のデジタル化を背景に、最先端から成熟世代まで幅広い範囲で投資がおこなわれました。NANDフラッシュメモリ向け設備投資は、高積層化に伴う需要を背景に高い水準で推移しましたが、当年度の後半に入り、DRAM向け設備投資と同様に、在庫調整に伴う投資の延期がありました。

このような状況のもと、当セグメントの当第3四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、1兆6,118億8千6百万円(前年同期比15.6%増)となりました。

#### ② FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置

テレビ用大型液晶パネル向け設備投資が一巡したことにより、FPD TFTアレイ向け製造装置市場全体としては減速傾向となりました。一方、中小型有機ELパネル向け設備投資については、最終製品に搭載されるディスプレイが液晶から有機ELへと転換されることに伴う投資が継続しました。

このような状況のもと、当セグメントの当第3四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、387億3千4百万円(前年同期比12.6%減)となりました。

#### ③ その他

当セグメントの当第3四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、1億8百万円(前年同期比8.3%増)となりました。

(ご参考)

## 【連結業績】

(単位：百万円)

	当期			
	第1Q	第2Q	第3Q	第3Q累計
売上高	473,654	709,243	467,831	1,650,729
半導体製造装置	464,003	689,061	458,820	1,611,886
日本	42,022	90,546	48,216	180,786
北米	67,325	108,305	58,469	234,100
欧州	56,526	50,990	42,604	150,120
韓国	85,172	84,289	75,406	244,868
台湾	96,816	133,829	110,149	340,795
中国	94,086	168,598	102,792	365,477
東南アジア他	22,055	52,502	21,179	95,737
F P D製造装置	9,614	20,144	8,975	38,734
その他	36	36	35	108
営業利益	117,519	232,646	114,771	464,936
経常利益	117,692	235,627	116,909	470,229
親会社株主に帰属する 四半期純利益	88,095	179,251	85,574	352,920

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

## (2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,858億6百万円増加し、1兆5,945億9百万円となりました。主な内容は、棚卸資産の増加1,582億1千7百万円、現金及び預金の増加981億8千1百万円、有価証券に含まれる短期投資の減少819億9千9百万円によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から231億1千6百万円増加し、2,461億9千4百万円となりました。

無形固定資産は、前連結会計年度末から49億4千7百万円増加し、274億8千7百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から155億6千7百万円減少し、2,245億6千7百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から1,983億2百万円増加し、2兆927億6千万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ1,084億6百万円増加し、5,769億8千5百万円となりました。主として、前受金の増加1,715億4千2百万円、未払法人税等の減少532億3千4百万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ25億4千6百万円増加し、813億7千6百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ873億4千9百万円増加し、1兆4,343億9千8百万円となりました。主として、親会社株主に帰属する四半期純利益3,529億2千万円を計上したことによる増加、前期の期末配当及び当期の中間配当2,529億8千8百万円の実施による減少、その他有価証券評価差額金の減少273億2千8百万円によるものであります。この結果、自己資本比率は68.0%となりました。

## (3) キャッシュ・フローに関する説明

現金及び現金同等物の当第3四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ361億6百万円増加し、3,717億5千4百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資157億2百万円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ161億8千2百万円増加し、3,874億5千7百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ39億1千4百万円減少の3,166億2千4百万円の収入となりました。主な要因につきましては、税金等調整前四半期純利益4,692億1千8百万円、前受金の増加1,709億6千万円がキャッシュ・フローの収入となり、法人税等の支払額1,753億3千8百万円、棚卸資産の増加1,543億8千2百万円がそれぞれキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として有形固定資産の取得による支出445億2千7百万円により、前年同期の399億2千5百万円の支出に対し337億9百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に配当金の支払2,529億8千8百万円により、前年同期の1,669億7千4百万円の支出に対し2,559億6千3百万円の支出となりました。

## 【連結キャッシュ・フロー(要約)】

(単位：百万円)

	前第3四半期 連結累計期間	当第3四半期 連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	320,539	316,624
税金等調整前四半期純利益	428,568	469,218
減価償却費	26,453	30,881
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)	△48,605	△16,259
棚卸資産の増減額(△は増加)	△71,485	△154,382
仕入債務の増減額(△は減少)	16,872	△14,045
その他	△31,264	1,211
投資活動によるキャッシュ・フロー	△39,925	△33,709
定期預金及び短期投資の増減額(△は増加)	4,913	19,936
その他(固定資産の取得等)	△44,839	△53,645
財務活動によるキャッシュ・フロー	△166,974	△255,963
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,645	9,154
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	117,283	36,106
現金及び現金同等物の期首残高	265,993	335,648
現金及び現金同等物の四半期末残高	383,277	371,754

現金及び現金同等物並びに満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資の四半期末残高	423,947	387,457
--	---------	---------

## (4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

マクロ経済の減速懸念や地政学リスクにより、足元では半導体メーカーの設備投資先送り・抑制の傾向が見られておりますが、通期連結業績予想につきましては、一部顧客における装置納入時期の精査や投資計画の前倒し等により、売上高が前回予想を上回る見通しとなったため、2022年11月10日に公表した数値を以下のとおり修正いたします。

## 2023年3月期通期の連結業績予想

	今回修正予想	前回予想 (2022年11月10日公表)
売上高	2兆1,700億円 (前期比 8.3%増)	2兆1,000億円
半導体製造装置	2兆1,180億円 (前期比 9.0%増)	2兆460億円
FPD製造装置	520億円 (前期比 13.1%減)	540億円
営業利益	5,800億円 (前期比 3.2%減)	5,460億円
経常利益	5,840億円 (前期比 2.9%減)	5,490億円
親会社株主に帰属する 当期純利益	4,330億円 (前期比 0.9%減)	4,000億円

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

※この決算短信に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

## 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	274,274	372,456
受取手形、売掛金及び契約資産	433,948	454,471
有価証券	97,000	15,001
商品及び製品	183,512	237,907
仕掛品	144,330	168,686
原材料及び貯蔵品	146,002	225,469
その他	129,796	120,657
貸倒引当金	△160	△139
流動資産合計	1,408,703	1,594,509
固定資産		
有形固定資産	223,078	246,194
無形固定資産		
その他	22,540	27,487
無形固定資産合計	22,540	27,487
投資その他の資産		
その他	241,434	225,903
貸倒引当金	△1,298	△1,335
投資その他の資産合計	240,135	224,567
固定資産合計	485,754	498,250
資産合計	1,894,457	2,092,760



(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	120,908	112,493
未払法人税等	107,193	53,958
前受金	102,555	274,097
製品保証引当金	26,568	32,764
賞与引当金	44,871	23,145
その他の引当金	5,353	2,826
その他	61,129	77,698
流動負債合計	468,578	576,985
固定負債		
その他の引当金	6,402	3,194
退職給付に係る負債	62,533	62,012
その他	9,894	16,169
固定負債合計	78,829	81,376
負債合計	547,408	658,361
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,011	78,011
利益剰余金	1,104,983	1,203,698
自己株式	△27,418	△22,539
株主資本合計	1,210,537	1,314,131
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	93,492	66,163
繰延ヘッジ損益	△52	27
為替換算調整勘定	30,640	41,581
退職給付に係る調整累計額	535	231
その他の包括利益累計額合計	124,615	108,003
新株予約権	11,895	12,264
純資産合計	1,347,048	1,434,398
負債純資産合計	1,894,457	2,092,760

## (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

## 四半期連結損益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
売上高	1,438,988	1,650,729
売上原価	783,108	918,010
売上総利益	655,880	732,718
販売費及び一般管理費		
研究開発費	114,096	137,427
その他	111,092	130,353
販売費及び一般管理費合計	225,188	267,781
営業利益	430,691	464,936
営業外収益		
持分法による投資利益	1,304	1,995
その他	3,649	5,049
営業外収益合計	4,954	7,045
営業外費用		
為替差損	1,581	759
その他	684	993
営業外費用合計	2,265	1,753
経常利益	433,380	470,229
特別利益		
固定資産売却益	5	4
特別利益合計	5	4
特別損失		
固定資産除売却損	240	576
減損損失	—	438
付加価値税追徴税額	4,577	—
特別損失合計	4,817	1,015
税金等調整前四半期純利益	428,568	469,218
法人税等	118,322	116,297
四半期純利益	310,246	352,920
親会社株主に帰属する四半期純利益	310,246	352,920

四半期連結包括利益計算書  
第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
四半期純利益	310,246	352,920
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	38,109	△27,335
為替換算調整勘定	7,331	10,803
退職給付に係る調整額	542	△292
持分法適用会社に対する持分相当額	86	212
その他の包括利益合計	46,069	△16,612
四半期包括利益	356,316	336,308
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	356,316	336,308

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用の計算

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

### 1. 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、BU(ビジネスユニット)を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」及び「FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置」を報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」の製品は、ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、エッチング装置、成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバ、及びウェーハレベルのボンディング/デボンディング装置などの半導体製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「FPD製造装置」の製品は、フラットパネルディスプレイ製造用のコータ/デベロッパ、エッチング/アッシング装置及び有機ELディスプレイ製造用インクジェット描画装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

### 2. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント		その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 3
	半導体 製造装置	FPD 製造装置				
売上高	1,611,886	38,734	25,811	1,676,432	△25,702	1,650,729
セグメント利益	521,712	1,056	872	523,641	△54,423	469,218

(注) 1. 「その他」は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの物流・施設管理・保険業務等であります。

2. セグメント利益の調整額△54,423百万円は、報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費△22,034百万円、及びその他の一般管理費等であります。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。

### 3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

## (重要な後発事象)

## 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更

当社は、2023年2月9日開催の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行うことを決議いたしました。

## 1. 株式分割の目的

株式分割を行い、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、より投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大を図ることを目的としております。

東京証券取引所が求めている望ましい投資単位(5万円以上 50万円未満)の水準への移行に関しましては、個人投資家の市場参加を促し、株式市場の活性化を図るために有用な手段の一つであると認識しておりますが、株式市場の動向や、当社株式の株価水準、流通状況、株主構成の変化等を総合的に考慮しながら、引き続き、検討してまいります。

## 2. 株式分割の概要

## (1) 分割の方法

2023年3月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記録された株主の所有する普通株式を、1株につき3株の割合をもって分割いたします。

## (2) 分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数	157,210,911株
株式分割により増加する株式数	314,421,822株
株式分割後の発行済株式総数	471,632,733株
株式分割後の発行可能株式総数	900,000,000株

## (3) 分割の日程

基準日公告日	2023年3月16日
基準日	2023年3月31日
効力発生日	2023年4月1日

## (4) 1株当たり情報に及ぼす影響

当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、以下のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
1株当たり四半期純利益	664円46銭	754円44銭
潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益	661円07銭	751円34銭

## 3. 株式分割に伴う定款の一部変更

## (1) 定款変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2023年4月1日をもって当社の定款第6条の発行可能株式総数を変更いたします。

## (2) 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更後定款
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は <u>300,000,000株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は <u>900,000,000株</u> とする。

## (3) 定款変更の日程

効力発生日 2023年4月1日

## 4. その他

配当について

今回の株式分割は、2023年4月1日を効力発生日としておりますので、2023年3月31日を基準日とする2023年3月期の期末配当は、株式分割前の株式数を基準に実施いたします。